



Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 21. november 2018
(OR. en)

14559/18
ADD 1

ENV 797
MI 870
DELECT 153

FØLGESKRIVELSE

fra:	Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen
modtaget:	19. november 2018
til:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union
Komm. dok. nr.:	C(2018) 7499 final - Annex
Vedr.:	BILAG til Kommissionens delegerede direktiv om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i loddemateriale til etablering af elektrisk forbindelse mellem halvlederskive og bæresubstrat i integrerede kredsløbspakker med flip chip

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2018) 7499 final - Annex.

Bilag: C(2018) 7499 final - Annex



EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 16.11.2018
C(2018) 7499 final

ANNEX

BILAG

til

Kommissionens delegerede direktiv

om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i loddemateriale til etablering af elektrisk forbindelse mellem halvlederskive og bæresubstrat i integrerede kredsløbspakker med flip chip

BILAG

Punkt 15 i bilag III affattes således:

"15.	Bly i loddemateriale til etablering af elektrisk forbindelse mellem halvlederskive og bæresubstrat i integrerede kredsløbspakker med flip chip	Gælder for kategori 8, 9 og 11 og udløber den: – 21. juli 2021 for kategori 8 og 9 undtagen medicinsk udstyr til vitro-diagnostik og industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter – 21. juli 2023 for kategori 8 medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik – 21. juli 2024 for kategori 9 industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter og for kategori 11.
15.a	Bly i loddemateriale til etablering af elektrisk forbindelse mellem halvlederskive og bæresubstrat i integrerede kredsløbspakker med flip chip, hvor mindst ét af følgende kriterier gør sig gældende: – der anvendes 90 nm-halvlederteknologi eller større – der anvendes en enkelt halvlederskive på 300 mm² eller derover sammen med hvilken som helst halvlederteknologi – stablede chippakker med en halvlederskive på 300 mm² eller derover eller silicium-interposere på 300 mm² eller derover	Gælder for kategori 1, 7 og 10 og udløber den 21. juli 2021."